

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 247
उत्तर देने की तारीख 27 नवम्बर, 2024

दूरसंचार क्षेत्र में तीव्र वृद्धि

247. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दूरसंचार क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के बावजूद भी संचार उपकरण विनिर्माण उद्योग को समुचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में स्वदेशी दूरसंचार विनिर्माण इकाईयों को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कठोर कदम उठाए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) सरकार देश में दूरसंचार उपकरण विनिर्माण उद्योग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। स्वदेशी दूरसंचार विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

1. दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम: पीएलआई स्कीम जून, 2021 में शुरू की गई थी। इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- 12,195 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय।
- कुल 33 दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद।
- प्रोत्साहन 4 से 7% तक।
- पहले 3 वर्षों के लिए एमएसएमई हेतु 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन।
- 'भारत में डिज़ाइन किए गए' उत्पादों के लिए 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन।

दिनांक 30.09.2024 की स्थिति के अनुसार, स्कीम का निष्पादन इस प्रकार है:

- o 28 एमएसएमई सहित कुल 42 आवेदक कंपनियां।
- o संचयी निवेश (करोड़ रुपए): 3,925
- o कुल बिक्री (करोड़ रुपए): 65,320
- o इनमें से निर्यात (करोड़ रुपए): 12,384

2. **दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) स्कीम:** टीटीडीएफ स्कीम दिनांक 01.10.2022 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं के अनुसंधान और विकास को वित्तपोषित करना था।

3. **डिजिटल संचार नवाचार केंद्र (डीसीआईएस) स्कीम:** डीसीआईएस स्कीम वर्ष 2021 में इंजीनियरिंग में नवीन विचारों और ज्ञान के पायलट स्केल ऑपरेशन, फील्ड परिनियोजन या व्यवहार्य प्रौद्योगिकी विकास में अंतरण का समर्थन करने के लिए शुरू की गई थी।

4. **बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम:** (पीएलआई): इस स्कीम को दिनांक 1 अप्रैल, 2020 को मोबाइल फोन विनिर्माण और असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) इकाइयों सहित विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट के विनिर्माण में शामिल वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के अलावा) पर पात्र कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया गया था।

5. **इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंटों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने संबंधी स्कीम (एसपीईसीएस):** इस स्कीम को दिनांक 1 अप्रैल, 2020 को उन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की चिह्नित की गई सूची के लिए पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए अधिसूचित किया गया था, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट, सेमीकंडक्टर/डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, एटीएमपी यूनिट, विशेष उप-असेंबलियाँ और उपरोक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुएँ शामिल हैं।

6. **संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी 2.0) स्कीम:** इस स्कीम को दिनांक 1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था, ताकि देश में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं को आकर्षित करने हेतु रेडी बिल्ट फैक्ट्री (आरबीएफ) शेड्स/प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित सामान्य सुविधाओं और सुख-सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना के विनिर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके। यह स्कीम पूरे देश में ईएमसी परियोजनाओं और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) दोनों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
